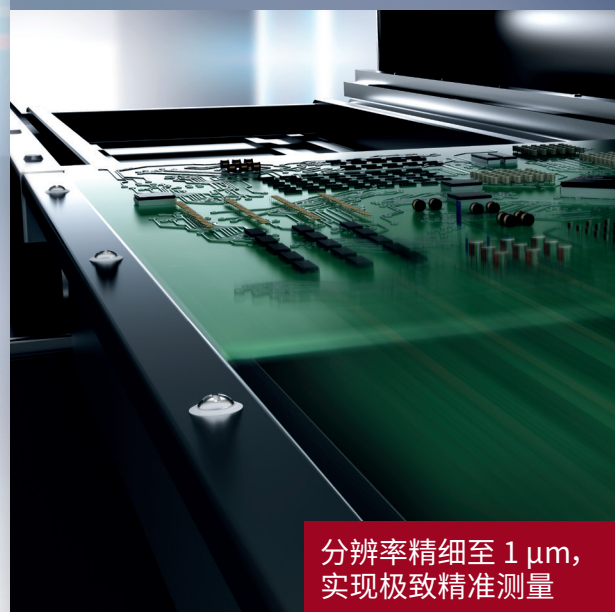




从实验室到工厂
(Lab-to-Fab) 的
3D X 光检测系统



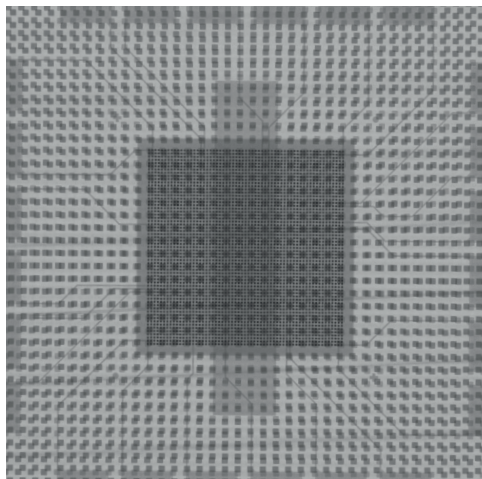
分辨率精细至 1 μm ,
实现极致精准测量

iX7059 One

ONE 作为一台检测系统是先进组件、功率模组和半导体产品的理想之选。

3D AXI

品牌最高分辨率检测系统, 适用于在线检测



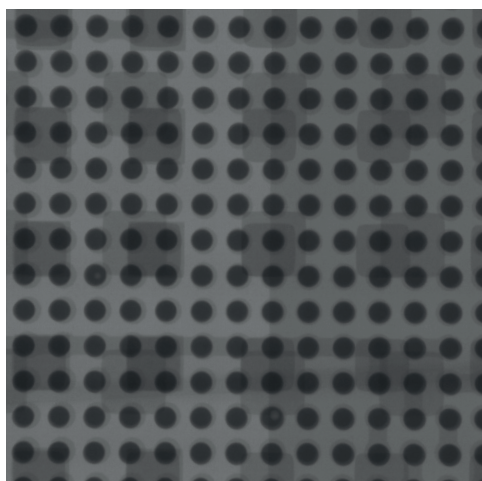
分辨率精细至 1 μm , 实现极致精准测量

采用强化景深, 在质量保证行业
成为了新的标杆

实时 2D、2.5D 以及 3D 超精准 X 光检测

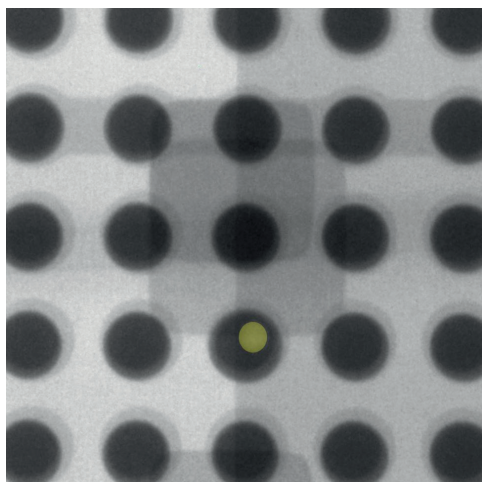
从研发到在线检测, 从实验室到工厂 (“Lab-to-Fab”)

专门针对半导体设备、引线框应用以及先进组件产品打造



现代化操作软件, 实现极速编程以及极简验证

全球范围内提供服务、热线支持以及远程维护



在追求卓越、精准的道路上我们绝不妥协。iX7059 One 让精准不再只是所追求的目标, 而是企业产品的名帖。搭载出类拔萃的图像处理技术, 系统可输出分辨率精细至 1 μm 且质量无可比拟的图像。从精密的半导体设备到复杂的引线框应用, 它总能以令人惊叹的清晰度捕捉每处细节。

但此台设备的精准性不拘泥于其在图像质量方面的表现。在识别和处理缺陷方面, 它始终如一的准确度也让人赞叹不已。iX 7059 One 凭借其强劲景深在缺陷识别领域树立了熠熠生辉的新标杆。无论是微不足道的瑕疵还是显而易见的失误, 任何缺陷都无法逃脱此款高级检测系统审慎的凝视。

多功能性让 iX 7059 One 脱颖而出。作为一款囊括 2D、2.5D 以及 3D X 光检测技能的全能检测设备, 它可胜任现代制造业中各式各样的检测需求。从内部结构精巧的单一半导体设备到需要全面分析的引线框应用, 此款独一无二的系统可针对各种线路板的批量生产实现 100% 的在线检测。

UPH 效率

受到半导体、功率模组以及先进组件产业日新月异的需求变化的影响, 引进 UPH 优化刻不容缓。请允许我们为您介绍 iX 7059 One!

iX 7059 One 的核心在于将前沿技术与 AI 驱动方法进行革新式融合。这样的融合为制造商打通了未曾体验过的高效之路, 不仅加速了其生产速度, 还通过智能决策拓宽了其生产能力。作为高速智能生产的一块基石, iX 7059 One 可确保制造商产出的每一个组件都经受住了严格检测, 拥有无可挑剔的超高质量。

除了速度优势之外, **iX 7059 One** 还关乎企业长远利益。通过在制造工艺初期阶段及时检测到孔隙或裂纹, 这台先进的检测设备在促成效率飞升的同时还能实现大量成本的节约。试想一条能在问题扩大之前便及时识别和修正潜在缺陷的生产线, 其出产的部件一定能一丝不苟地满足最高质量标准要求。

重新定义兼容性

在今天这个共创互联的世界中, 兼容性不仅仅局限于硬件, 还关乎协同合作。这正是我们开发 vConnect——一款旨在解锁 iX7059 One 最大化潜力的多功能数字平台——的原因。vConnect 可无缝接入您现有设备架构, 提供实时数据, 协助您每次做出周全的决策, 助力优化运营。

您是否也希望在获得俯瞰全局的超能力的同时, 还能巨细无遗地实时追踪和分析每个部件以及工艺流程? 使用 vConnect, 这不再仅仅是一个梦想。无论在监测检测结果、分析性能指标, 还是识别可优化区域, vConnect 将赋予您数据化的无限魔力。

vConnect:

Viscom 全新多功能平台, 带您亲身体验下一个级别的数字化联通性。

vConnect 是专门针对 Viscom 服务而提供的用户控制中心平台。vConnect 可简化您的操作流程, 协助您毫不费力地监察和控制设备的技术状态。Condition Monitoring 功能为您提供实时数据, 并使用仪表图向您图形化展示设备的当前状态。除此之外, 您还可以通过使用 vConnect Predictive Maintenance 的各类元件功能提升您保养作业的效率。

您也可以重组、定制或个性化设计您的仪表图。无论在本地还是云端, 我们将提供可扩展的存储容量解决方案, 一扫无法保存海量数据的后顾之忧。针对包括云连接和云使用功能在内的各类现代化解决方案, 我们竭诚为您提供支持服务。备份服务可防范安全漏洞和数据丢失。

全新高度的智能互联将为您创造焕然一新的体验, 而提升您设备的生产效率是我们携手共进的一致目标!

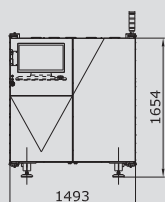




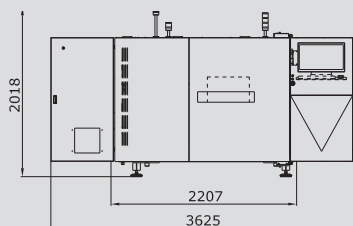
技术规格

iX7059 One

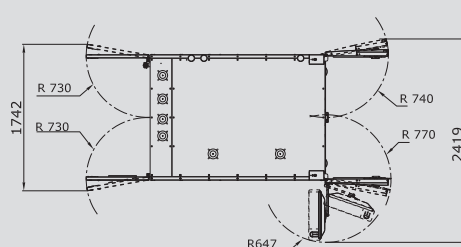
正视图



侧视图



俯视图



尺寸单位:mm

		iX7059 One - 引线框	iX7059 One - 托架	iX7059 One Special
X 光技术	X 光发生管	密封微焦 X 光发生管		
	高压	110kv		
	管电流	最高 200 μ A		
	探测器	FPD T3 (T4 可选), 14 位灰值深度		
	分辨率	1 - 25 μ m/pixel		
	3D 图像捕捉模式	标准为 Evolution 5, 选配为 Evolution 6		
	X 光机箱	根据德国《辐射防护法》(German Radiation Protection Act, StrlSchG) 和《德国辐射防护条例》(German Radiation Protection Ordinance, StrlSchV) 的要求, 旨在满足完全保护的设备的设备要求。辐射泄漏率 < 1 μ Sv/h		
软件	用户界面	Viscom vVision		
	统计进程控制	Viscom vSPC / SPC, 开放式接口 (可选)		
	验证维修站	Viscom vVerify		
	远程诊断	Viscom SRC (可选)		
	编程站	Viscom PST34 (可选)		
	操作系统	Windows®		
	处理器	Intel® Core™ i7		
处理	产品尺寸	最大 300 mm x 550 mm (11.8" x 21.6") (长 x 宽) *	最大 500 mm x 500 mm (19.6" x 19.6") (长 x 宽) *	最大 500 mm x 500 mm (19.6" x 19.6") (长 x 宽) *
	产品重量	最大 5 Kg (11 lbs)		
	夹紧装置厚度	0 - 2.5 mm**	5.5 - 11 mm**	2.5 - 5.5 mm**
	转运高度	860 - 980 mm $\pm$ 20 mm (33.8" - 38.5" $\pm$ 0.7")		
	宽度调整	设置过程中自动进行		
	夹紧装置	气动		
	支架	3 mm (0.1")		
	上方通行高度	2 - 50 mm (0.07 - 1.9")		
	下方通行高度	50 mm (1.9")		
其他系统数据	定位单元	同步线性电机		
	接口	SECS/ GEM、SMEMA、IPC Hermes (选配)		
	能源要求	400V (其他电压请具体咨询), 3P / N / PE, 8A, 4-6 bar 的工作压力		
	系统规格	1493 mm x 1654 mm x 2207 mm (58.7" x 65.1" x 86.8") (宽 x 高 x 长)		
	生产线集成尺寸	双侧 +30 mm (1.1")		
	重量	2255 kg (4971.4 lbs)*		

规格和其它系统信息如有变更, 恕不另行通知。详情以订购时的信息为准, 可能与此处所述有所不同。

*取决于配置
**其它夹紧装置厚度敬请咨询

我们的国际分部和代表处请查询网站: